

PROGRAM II Międzynarodowego Seminarium Klejenia pt.:

Klejenie w aplikacjach przemysłowych,

które odbędzie się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu, podczas Targów Technologii Klejenia ExpoBONDING, w dniach **21-22.11.2018 r.**

Dzień 1 – 21.11.2018

10⁰⁰ Zarządzanie jakością i normy
Dr. Erik Meiß – IFAM, Bremen

11³⁰ Przerwa kawowa

12⁰⁰ Kleje. Przygotowanie powierzchni
Dr. Erik Meiß – IFAM, Bremen

13³⁰ Obiad. Zwiedzanie targów

14³⁰ Aktywacja powierzchni
Dr. Erik Meiß – IFAM, Bremen

15³⁰ Wpływ obróbki powierzchni plazmą niskotemperaturową na właściwości mechaniczne złączy klejowych
dr inż. Tomasz Wojdat, prof. dr hab. inż. Zbigniew Mirski, inż. Dagmara Łądyszkowska – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa

16⁰⁰ Analiza jakości hybrydowych złączy klejowo-zgrzewanych
dr inż. Tomasz Piwowarczyk – Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałoznawstwa, Wytrzymałości i Spawalnictwa

16³⁰ AMB Technic – aktywacja powierzchni
Mariusz Zawierucha

17¹⁵ Podsumowanie i dyskusja

18⁰⁰ Uroczysta kolacja

Dzień 2 – 22.11.2018

9⁰⁰ Zwiedzanie targów

10⁰⁰ Rodzaje instalacji klejowych w przemyśle kolejowym – przykłady oraz typowe zagrożenia dla procesu
mgr Adrian Czajerek

10⁴⁵ Realizacja założeń normy DIN6701 w praktyce
mgr Adrian Czajerek

11³⁰ Przerwa kawowa

12⁰⁰ Zastosowanie warstwy specjalnej jako metody przygotowania powierzchni przed procesem klejenia
mgr inż. Beata Rams – Instytut Spawalnictwa, Tadeusz Bugalski ATOP

12³⁰ Zgrzewanie rezystancyjne punktowe z klejeniem blach stalowych
mgr inż. Szymon Kowieski – Instytut Spawalnictwa

12⁵⁰ Technologie klejenia i automatyzacja procesów montażowych
Andrzej Krypa, Technical Customer Service Manager, Henkel Adhesive Technologies

13³⁰ Belzona – technika spajania na zimno
Roman Masek – Belse Sp. z o.o.

14¹⁰ Podsumowanie, dyskusja, wręczenie zaświadczeń

14³⁰ Obiad i zwiedzanie targów